

项目名称

*集成电路*封装芯片

*集成电路*封装芯片

信息

50000 0.0619469026549

120000 0.0619469026549

数量

发票号码: 23322000000113463641

税率/征收率

13%

13%

开票日期: 2023年12月26日

载次数:

税 额

402.65

966.37

购买方 信息

名称: 苏州华芯微电子股份有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 913205007244068662

HS2303-P-S0P16

HS2303-P-S0P16

单位

只

只

规格型号

销 名称:江苏芯丰集成电路有限公司 售方

价

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91320903MA22DQUG6W

金 额

3097.35

7433.63

合	计			¥83415.87		¥10844.03
*集成电路*封装芯片	HS2303-P-S0P16	只	20000 0.0619469026549	1238. 94	13%	161. 06
*集成电路*封装芯片	HS9000P-P16- S0P16	只	50000 0.0619469026549	3097. 35	13%	402. 65
2,0,0,0	HS9000P-P16- S0P16	只	50000 0.0619469026549	3097. 35	13%	402. 65
*集成电路*封装芯片 *集成电路*封装芯片	HS2303-P-S0P16	只口	90000 0. 0619469026549	5575. 22	13%	724. 78
*集成电路*封装芯片	HS9000P-P16- S0P16	只	190000 0.0619469026549	11769. 91	13%	153 0. 09
*集成电路*封装芯片	HS9000P-P16- S0P16	只	200000 0. 0619469026549	12389. 38	13%	1610. 62
*集成电路*封装芯片	HS2303-P-S0P16	只	65165 0. 0619469026549	4036.77	13%	524. 78
*集成电路*封装芯片	HS2303-P-S0P16	只	61405 0.0619469026549	3803.85	13%	494. 50
*集成电路*封装芯片	HS2303-P-S0P16	只	40000 0.0619469026549	2477.88	13%	322. 12
*集成电路*封装芯片	HS2303-P-S0P16	只	100000 0.0619469026549	6194.69	13%	805. 31
*集成电路*封装芯片	HS2303-P-S0P16	只	50000 0.0619469026549	3097.35	13%	402. 65
*集成电路*封装芯片	HS2303-P-S0P16	只	40000 0. 0619469026549	2477.88	13%	322. 12
*集成电路*封装芯片	HS2303-P-S0P16	只	220000 0.0619469026549	13628.32	13%	1771. 68

价税合计(大写)

≫玖万肆仟贰佰伍拾玖圆玖角整

(小写) ¥94259.90

购方开户银行:交通银行苏州高新技术产业开发区支行; 银行账号:325604000018000062643; 销方开户银行:中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行; 银行账号:10400101040258099;

备 注

开票人: 蔡小峰